

特点

- 芯片与底板电气绝缘，交流电压
- 国际标准封装：全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力
- 以下模块皆为强迫风冷，以上模块，风冷，水冷先用

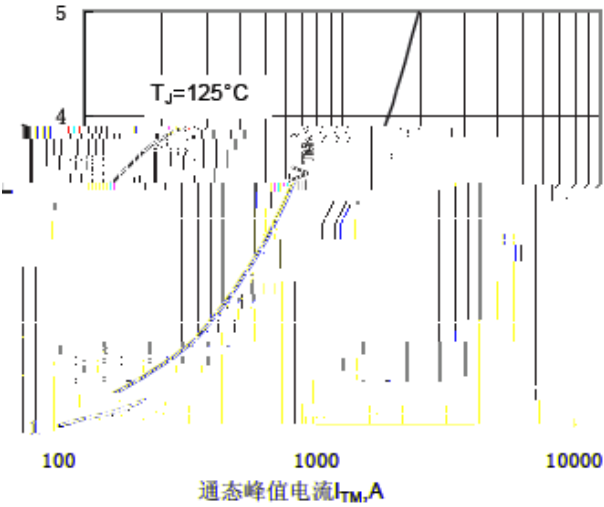
典型应用

- 交直流电机控制，各种整流电源
- 工业加热控制，调光，无触发点开关
- 电机软起动，静止无功补偿
- 电焊机，变频器，电源，电池充放电

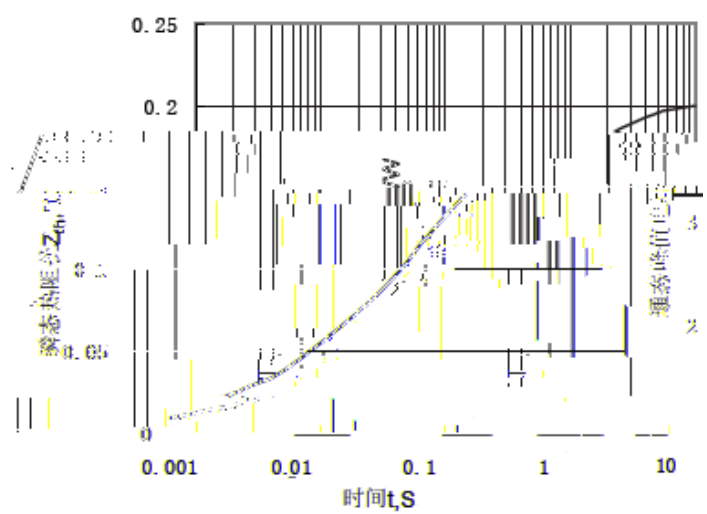
2G	2
G _{5C} G _{CC}	& & G
D) 2
e	(Rd

				最小	典型	最大	
2G) 半波, & K 双面散热, 4.)&	&				2
C D	方 根		&				2
G _{5C} G _{CC}	断 重复峰 压 反向重复峰 压	G _{5C} G _{CC} ea. d G _{5D} G _{CD} G _{5C} G _{CC} G	&	&		&	G
G _{5C} G _{CC}	断 重复峰 反向重复峰	G ₅ G _{5C} G _C G _{CC}	&				2
D	不重复浪涌	d底宽, 半波	&)	2
e	浪涌 方时间积	G _C G _{CC}	&			(2 ^D
G	门槛 压		&)	G
c	斜率 阻		&)&	Ω
G	峰 压	. 2	&				G
g e	断 压临界上升率	G ₅ . (G _{5C}	&)	G d
Z e	临界上升率	. & 2 门极触发 幅 8c. & 2 门极 上 ≦ 升时间 e ≦ & d	&				2 d
8	门极触发		&				2
G ₈	门极触发 压	G ₂ . G 2. 2	&			&	G
	维持					&	2
G ₈₅	门极不触发 压	G ₅ . (G _{5C}	&				G
C _{e T}	热阻抗 (至壳)) 波, 面散热					H
C _{e T}	热阻抗 (壳至散)) 波, 面散热)	H
G _{AI}	绝缘 压		&				G
7	安装扭矩 (& 安装扭矩 (
d	储存 度					&	
H _e	质量						
eZV	外形						

Peak On-state Voltage Vs. Peak On-state Current

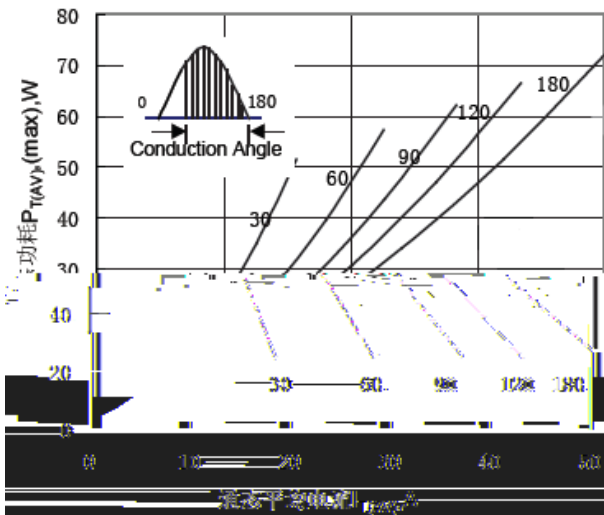


Max. junction To case Thermal Impedance Vs. Time

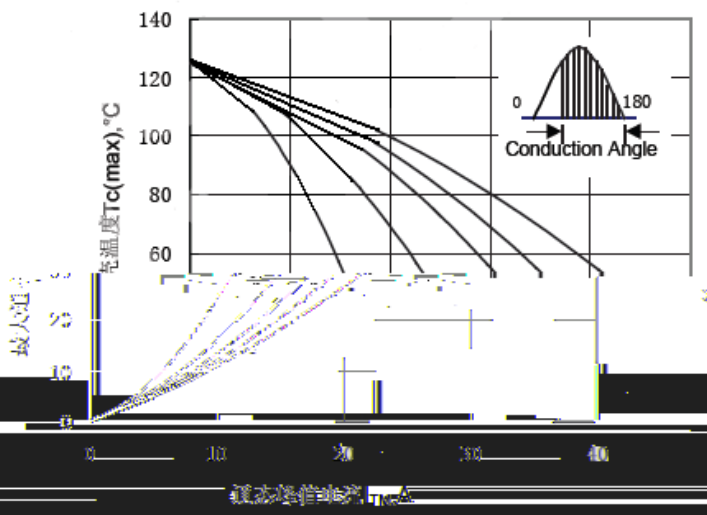


结至管壳瞬 热阻抗

Max. Power Dissipation Vs. Mean On-state Current



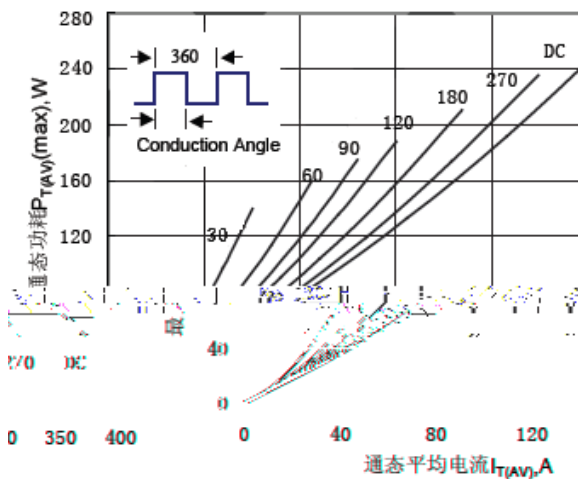
Max. case Temperature Vs. Mean On-state Current



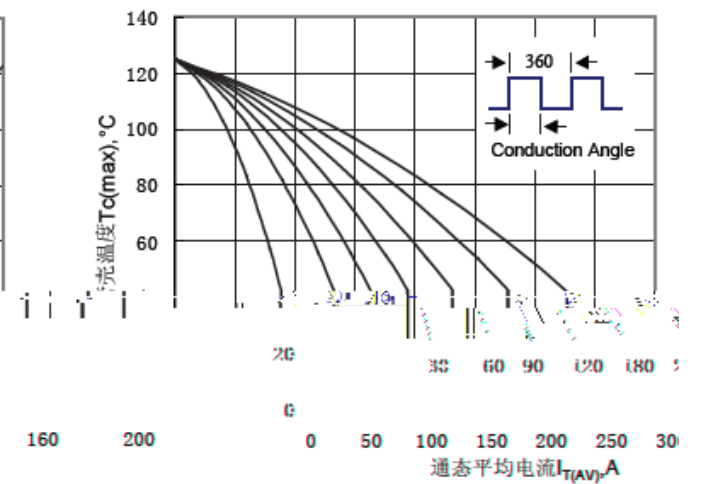
最大功耗与平均电流关系

管壳温度与 平均电流关系

Max. case Temperature Vs. Mean On-state Current



Max. case Temperature Vs. Mean On-state Current



最大功耗与平均电流关系

管壳温度与 平均电流关系

线路图：

